孔铜测厚仪 CMI511



**孔铜测厚仪 CMI511**

     第一台带温度补偿功能的测量孔内镀铜厚度的便携式测厚仪CMI511，是手持的电池供电的测厚仪。用于PCB侵蚀工序前、后孔内镀层厚度测量。独特的设计使CMI511能够完全胜任对双层或多层电路板的测量，甚至可以穿透锡和锡/铅抗蚀层进行测量。

   CMI511独有的温度补偿特性使其适用于在电镀过程中进行厚度测量，从而降低废料、返工成本。

   CM511在售前和售后都能够得到牛津仪器的优质服务的保证。

**应用**

  测试蚀刻前后的孔内镀铜厚度

**行业**

  PCB制造厂商及采购买家

**配置**

* 500 SERIES主机
* ETP探头
* NIST认证的校验用标准片1件

**技术参数**

* 可测试最小孔直径：35 mils (899 μm)
* 测量厚度范围：0.08 – 4.0 mils (1 – 102 μm)
* 电涡流原理：遵守ASTM-E376-96标准的相关规定
* 准确度：±0.01 mil (0.25 μm) < 1 mil (25 μm)
* 精确度：1.2 mil（30μm）时，达到1.0% （实验室情况下）
* 分辨率：0.01 mils (0.1μm)
* 校正方式:  单点标准片校正
* 显示屏:  高亮度液晶显示屏，1/2英吋(1.27mm)高
* 单  位:  以按键切换公制(um)及英制(mils)单位选择
* 连接口:  RS-232连接口，用于将数据传输至计算机或打印机
* 统计数据:  量测点数、平均值、标准差、最高值、最低值、由打印机可输出直方图或CPK图
* 储存量:  2000条读数
* 重  量:  9 oZ(0.26Kg)含电池
* 尺  寸:  149\*794\*302 mm
* 电  池:  9伏干电池或可充电电池
* 电池持续时间:  9伏干电池－50小时 9伏充电电池－10小时
* 打印机:  任意竖式热感打印机
* 按  键:  密封膜，增强-16键